

第 106 回マイクロ接合研究委員会 プログラム

日 時：平成 26年 4月 23日(水) 13:00～17:00

場 所：東京ビッグサイト(東京国際展示場:会議棟 6 階 607 会議室)

	時 間	題 目	講 演 者
平成 26 年 4 月 23 日 (水)	司 会 佐野 智一 （大阪大学）		
	13:00～13:10	『マイクロ接合研究委員会の活動紹介』	大阪大学 ○廣瀬明夫
	13:10～14:05	『ナノ粒子コーティングの現状と課題』	東北大学 ○小川和洋
	14:05～15:00	『フェムト秒レーザによる透明材料の直接接合』	大阪大学 ○伊東一良
	15:00～15:10	休 憩	
	司 会 中島 泰 （三菱電機(株)）		
	15:10～16:05	『薄板の摩擦攪拌接合技術』	(株)日立製作所 ○佐藤章弘, 平野 聡 青田欣也
	16:05～17:00	『ナノ微小構造体に対する機械強度評価』	京都大学 ○北村隆行, 澄川貴志 河合江美

※プログラムは都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。